

4-2-3-6 下地Ni腐食金めっきピット／基底镍层被腐蚀引起镀金层的凹坑 / Gold plating pit on corroded Ni basis

【特徴】 無電解金めっきの表面の一部が黒く腐食状になっている欠陥

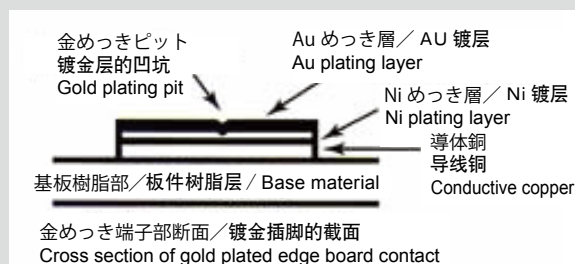
【特征】 在沉金表面的局部有黑色腐蚀形状的缺陷。

【Characteristics】 A part of the surface of electroless gold plating is turned black and looks like corroded.

【原因・判断ポイント・発生工程】 金めっきの置換反応が過度に進行し、ニッケルめっきの析出粒界を侵食・酸化して出来たもの（Niめっき後～金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】 镀金的置换反应过度，侵蚀或者氧化镀镍的沉积颗粒所引起的（镀镍后～镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 The substitution reaction of gold plating is progressed too much so that the grain boundary of nickel deposition is also etched and oxidized, causing the defect. (After nickel plating-gold plating)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-2-4 その他（金めっき欠陥）／其它（镀金层缺陷）／ Others(gold plating defects)

4-2-4-1 金めっき端子ドリル穴残り／镀金插脚上有多余孔 / Trace of drilled hole on gold edge board contact

【特徴】 金めっき端子部にドリル穴跡が残っている状態の欠陥

【特征】 在镀金插脚上有钻孔痕迹的缺陷。

【Characteristics】 The trace of a drilled hole is present on a gold edge board contact area.

【原因・判断ポイント・発生工程】 金めっき端子部分に無駄なドリル穴が明けられたために出来たもの（穴明け工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在镀金插脚上钻了多余孔所引起的（钻孔工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 The defect is caused by a useless hole drilled in a gold edge board contact area (Drilling process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×